

2015-2020年中国LED封装市场现状分析及投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2015-2020年中国LED封装市场现状分析及投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/qitadianzi1412/N51984WYHL.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7000元 纸介+电子7200元

【出版日期】2014-12-19

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

报告说明:

博思数据发布的《2015-2020年中国LED封装市场现状分析及投资前景研究报告》共七章，报告从行业概况、市场格局、设备及原材料、重点企业等多方面多角度阐述了LED封装市场的总体发展状况，并在此基础上对中国LED封装市场的发展前景进行分析和预测。LED封装是指发光芯片的封装，是与市场联系最为紧密的环节。由于封装的技术含量与投资门槛相对较低，因此它是LED产业链中投资规模最大且发展最快的领域。

近年来，传统半导体封装企业开始试水LED封装，半导体封装设备厂商逐步加大LED设备的研发和市场推广，封装企业更多向下游应用领域延伸，且不乏有部分实力企业向上游扩张。

我国LED封装产品经过十多年的发展，已形成门类齐全的各类封装型号，与国外的封装产品型号基本同步。中国已逐渐成为世界LED封装器件的制造中心，内地LED封装企业的封装产能扩充较快。国内LED封装企业主要分布在珠三角地区，其次是长三角地区。随着更多资本进入大陆封装产业，我国LED封装产能将会进一步扩张。

报告目录

第一章 LED封装相关概述

1.1 LED封装简介

1.1.1 LED封装的概念

1.1.2 LED封装的形式

1.1.3 LED封装的结构类型

1.1.4 LED封装的工艺流程

1.2 LED封装的常见要素

1.2.1 LED引脚成形方法

1.2.2 LED弯脚及切脚

1.2.3 LED清洗

1.2.4 LED过流保护

1.2.5 LED焊接条件

第二章 2013-2014年LED封装产业总体发展分析

- 2.1 2013-2014年世界LED封装业的发展
 - 2.1.1 总体特征
 - 2.1.2 区域分布
 - 2.1.3 企业格局
- 2.2 2013-2014年中国LED封装业的发展
 - 2.2.1 发展现状
 - 2.2.2 产值增长情况
 - 2.2.3 产品结构分析
 - 2.2.4 产业链分析
 - 2.2.5 产能分析
 - 2.2.6 价格分析
- 2.3 2013-2014年国内重要LED封装项目进展
 - 2.3.1 欧司朗在华首个LED封装项目投产
 - 2.3.2 福建安溪引进LED封装线项目
 - 2.3.3 瑞丰光电扩产SMD LED项目
 - 2.3.4 徐州博润LED芯片封装项目开建
 - 2.3.5 晶圆级芯片封装项目落户淮安
 - 2.3.6 厦门信达增资扩建LED封装项目
- 2.4 SMD LED封装
 - 2.4.1 SMD LED封装市场发展简况
 - 2.4.2 SMD LED封装技术壁垒较高
 - 2.4.3 SMD LED封装产能尚未过剩
 - 2.4.4 SMD LED封装受益于芯片价格下降
- 2.5 LED封装业发展中存在的问题
 - 2.5.1 制约我国LED封装业发展的因素
 - 2.5.2 国内LED封装企业面临的挑战
 - 2.5.3 传统封装工艺成为系统成本瓶颈
 - 2.5.4 封装企业选择不当发展模式
- 2.6 促进中国LED封装业发展的策略
 - 2.6.1 做大做强LED封装产业的对策
 - 2.6.2 发展LED封装行业的措施建议
 - 2.6.3 LED封装业发展需加大研发投入

2.6.4 我国LED封装业应向高端转型

第三章 2013-2014年中国LED封装市场格局分析

3.1 2013-2014年LED封装市场发展态势

3.1.1 LED封装市场运行特征

3.1.2 LED封装市场需求结构

3.1.3 LED封装企业规模扩大

3.1.4 LED封装市场发展变局

3.1.5 封装市场上下游战略合作

3.2 2013-2014年LED封装企业布局特征

3.2.1 区域分布格局

3.2.2 珠三角地区分布特点

3.2.3 长三角地区分布特点

3.2.4 其他地区分布特点

3.3 2013-2014年广东省LED封装业分析

3.3.1 产业规模

3.3.2 主要特点

3.3.3 重点市场

3.3.4 发展趋势

3.4 2013-2014年LED封装市场竞争格局

3.4.1 LED封装市场竞争加剧

3.4.2 LED封装市场竞争主体

3.4.3 台湾厂商扩大封装产能

3.4.4 本土企业布局背光封装

3.4.5 封装企业竞争焦点分析

3.5 2013-2014年LED封装企业竞争力简析

3.5.1 2012年LED照明白光封装企业竞争力排名

3.5.2 2013年LED照明白光封装企业竞争力排名

3.5.3 2013年本土LED封装企业竞争力排名

3.5.4 2014年本土COB封装企业竞争力排名

第四章 2013-2014年LED封装行业技术研发进展

- 4.1 中外LED封装技术的差异
 - 4.1.1 封装生产及测试设备差异
 - 4.1.2 LED芯片差异
 - 4.1.3 封装辅助材料差异
 - 4.1.4 封装设计差异
 - 4.1.5 封装工艺差异
 - 4.1.6 LED器件性能差异
- 4.2 2013-2014年中国LED封装技术研发分析
 - 4.2.1 封装技术影响LED光源发光效率
 - 4.2.2 LED封装专利申请状况
 - 4.2.3 LED封装行业技术特点
 - 4.2.4 LED封装技术创新进展
 - 4.2.5 LED封装技术壁垒分析
 - 4.2.6 LED封装业技术研发仍需加强
- 4.3 LED封装关键技术介绍
 - 4.3.1 大功率LED封装的关键技术
 - 4.3.2 显示屏用LED封装的技术要求
 - 4.3.3 固态照明对LED封装的技术要求

第五章 2013-2014年LED封装设备及封装材料的发展

- 5.1 2013-2014年LED封装设备市场分析
 - 5.1.1 LED封装设备需求特点
 - 5.1.2 LED封装设备市场格局
 - 5.1.3 LED封装设备国产化提速
 - 5.1.4 LED前端封装设备竞争加剧
 - 5.1.5 LED后端封装设备市场态势
 - 5.1.6 LED封装设备市场发展方向
 - 5.1.7 LED封装设备市场规模预测
- 5.2 LED封装的主要材料介绍
 - 5.2.1 LED芯片
 - 5.2.2 荧光粉
 - 5.2.3 散热基板

- 5.2.4 热界面材料
- 5.3 2013-2014年中国LED封装材料市场分析
 - 5.3.1 LED封装材料市场现状
 - 5.3.2 2014年LED芯片产能分析
 - 5.3.3 2014年LED荧光粉价格走势
 - 5.3.4 LED封装辅料市场面临洗牌
 - 5.3.5 LED封装环氧树脂市场潜力巨大
 - 5.3.6 LED封装用基板材料市场走向分析
- 5.4 2013-2014年LED封装支架市场分析
 - 5.4.1 LED封装支架市场发展规模
 - 5.4.2 LED封装支架市场竞争格局
 - 5.4.3 LED封装支架市场技术路线
 - 5.4.4 LED封装PCT支架市场前景
 - 5.4.5 LED封装支架技术发展趋势

第六章 2013-2014年国内外重点LED封装企业分析

- 6.1 国外主要LED封装重点企业
 - 6.1.1 日亚化学 (NICHIA)
 - 6.1.2 欧司朗(OSRAM GmbH)
 - 6.1.3 三星电子 (SAMSUNG ELECTRONICS)
 - 6.1.4 首尔半导体 (SSC)
 - 6.1.5 科锐 (CREE)
- 6.2 台湾主要LED封装重点企业
 - 6.2.1 亿光电子
 - 6.2.2 隆达电子
 - 6.2.3 光宝集团
 - 6.2.4 东贝光电
 - 6.2.5 宏齐科技
 - 6.2.6 佰鸿股份
- 6.3 内地主要LED封装重点企业
 - 6.3.1 鸿利光电
 - 6.3.2 瑞丰光电

- 6.3.3 长方照明
- 6.3.4 国星光电
- 6.3.5 木林森
- 6.3.6 杭科光电
- 6.3.7 晶台股份

第七章 博思数据关于中国LED封装产业发展趋势及前景

- 7.1 LED封装产业未来发展趋势
 - 7.1.1 功率型白光LED封装技术趋势
 - 7.1.2 无金线封装成LED封装新走向
 - 7.1.3 LED封装产业未来发展方向
- 7.2 中国LED封装市场前景展望
 - 7.2.1 我国LED封装市场发展前景乐观
 - 7.2.2 LED封装产品应用市场将持续扩张
 - 7.2.3 中国LED通用照明封装市场前景预测

图表目录

- 图表1 LED产品封装结构的类型
- 图表2 2013年全球前十大封装厂商营业收入排名
- 图表3 全球主要LED封装企业的技术特色
- 图表4 第三类企业的发展运作模式
- 图表5 国际大部分著名LED企业遵循的发展模式
- 图表6 2006-2012年我国LED封装行业产值
- 图表7 不同LED封装类型产品图示
- 图表8 2012年我国LED封装市场增长率
- 图表9 台湾、大陆主要SMD LED企业产能对比
- 图表10 2010年在大陆扩产的主要港台企业
- 图表11 国星光电LED芯片单价变动对LED封装产品毛利的影响
- 图表12 2013年国内LED封装市场重点企业整合动态
- 图表13 广东部分LED封装企业的优势与特色
- 图表14 部分广东省企业和研究机构的封装技术发明专利分布
- 图表15 广东LED器件封装应用领域

- 图表16 2013年台湾重点LED封装厂商营业收入及其增长情况
- 图表17 2012年我国照明用白光LED封装企业竞争力排行榜
- 图表18 2013年我国照明用白光LED封装企业竞争力排行榜
- 图表19 2013年我国LED封装企业竞争力排行榜
- 图表20 2014年我国COB封装企业竞争力排行榜
- 图表21 影响大功率LED封装技术的因素
- 图表22 大功率LED的封装结构
- 图表23 LED封装技术的发展阶段
- 图表24 国内主要LED封装设备企业产品介绍
- 图表25 2013-2014年6月末广州市鸿利光电股份有限公司总资产和净资产
- 图表26 2012-2013年广州市鸿利光电股份有限公司营业收入和净利润
- 图表27 2014年1-6月广州市鸿利光电股份有限公司营业收入和净利润
- 图表28 2012-2013年广州市鸿利光电股份有限公司现金流量
- 图表29 2014年1-6月广州市鸿利光电股份有限公司现金流量
- 图表30 2013年广州市鸿利光电股份有限公司主营业务收入分行业、产品、地区
- 图表31 2013-2014年6月末深圳市瑞丰光电子股份有限公司总资产和净资产
- 图表32 2012-2013年深圳市瑞丰光电子股份有限公司营业收入和净利润
- 图表33 2014年1-6月深圳市瑞丰光电子股份有限公司营业收入和净利润
- 图表34 2012-2013年深圳市瑞丰光电子股份有限公司现金流量
- 图表35 2014年1-6月深圳市瑞丰光电子股份有限公司现金流量
- 图表36 2013年深圳市瑞丰光电子股份有限公司主营业务收入分行业、产品、地区
- 图表37 2013-2014年6月末深圳市长方半导体照明股份有限公司总资产和净资产
- 图表38 2012-2013年深圳市长方半导体照明股份有限公司营业收入和净利润
- 图表39 2014年1-6月深圳市长方半导体照明股份有限公司营业收入和净利润
- 图表40 2012-2013年深圳市长方半导体照明股份有限公司现金流量
- 图表41 2014年1-6月深圳市长方半导体照明股份有限公司现金流量
- 图表42 2013年深圳市长方半导体照明股份有限公司主营业务收入分产品、地区情况
- 图表43 2013-2014年6月末佛山市国星光电股份有限公司总资产和净资产
- 图表44 2012-2013年佛山市国星光电股份有限公司营业收入和净利润
- 图表45 2014年1-6月佛山市国星光电股份有限公司营业收入和净利润
- 图表46 2012-2013年佛山市国星光电股份有限公司现金流量
- 图表47 2014年1-6月佛山市国星光电股份有限公司现金流量

图表48 2013年佛山市国星光电股份有限公司主营业务收入分行业、产品、地区

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/qitadianzi1412/N51984WYHL.html>